

博敏电子股份有限公司

2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告

BOMIN 博敏

二〇二六年七月

为满足博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需求，增强公司资本实力，优化公司资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次以简易程序向特定对象发行股票”）。现将本次募集资金使用的可行性分析说明如下：

一、本次募集资金的使用计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币30,000.00万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	800G及以上数连产品用印制电路板项目	29,928.11	24,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	6,000.00	6,000.00
合计		35,928.11	30,000.00

注：募集资金金额实际以扣除相关发行费用后的募集资金净额为准。

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）800G及以上数连产品用印制电路板项目

1、项目概况

项目名称	800G及以上数连产品用印制电路板项目
实施主体	江苏博敏电子有限公司
项目总投资	29,928.11万元
拟投入募集资金金额	24,000.00万元

项目建设内容	本项目基于公司多年行业经验及技术积累，结合政策环境、行业发展趋势及下游客户需求情况，拟投资建设“800G及以上数连产品用印制电路板”项目；本项目计划在现有生产厂房内实施，通过购置先进生产设备开展扩产；项目建成后，公司将新增年产800G及以上高速数连产品6万平方米。
项目建设地点	盐城市大丰区开发区永圣路9号
项目建设周期	6个月

2、项目实施的必要性

(1) 把握市场机遇，扩大主营业务规模

受益于人工智能、数据中心、高性能计算等技术的驱动，服务器市场的强劲需求将带动高多层板、高阶 HDI 等高端 PCB 产品市场的增长。根据 Prismark 数据，2025 年，用于服务器和存储的 PCB 产值同比增长 43.6%，达到 156.75 亿美元，超越手机成为 PCB 最大下游应用领域。随着数据通信行业的快速迭代与规模扩张，将直接带动数连产品用 PCB 的市场规模持续扩容，行业发展前景广阔。

基于此，近年来，公司深度聚焦数据中心及服务器行业等 PCB 下游应用的细分赛道，精准对接市场需求，订单规模实现显著增长，成长确定性明确。面对日益扩大的市场需求，公司现有产能已难以满足客户规模化采购需求，亟需通过本次募投项目加大投入，扩大生产能力。本次项目实施后，公司将新增 800G 及以上高速数连产品 6 万平方米的产能，能够有效匹配数据通信行业等领域的市场需求，进一步抢占高端市场份额，巩固行业地位。

(2) 顺应行业技术发展趋势，提高市场竞争力

数据通信领域对高性能计算和高速数据传输的需求不断提升，驱动了 PCB 在技术上的快速迭代。为满足高负载、高频运算需求，PCB 产品需具备高密度互联、多层设计和高频信号传输能力，进一步提升了单位高端 PCB 产品售价。在市场和性能的双重需求下，高端服务器为 PCB 市场中增长最快的下游细分领域。本次募投项目系公司及时响应下游行业对高端服务器用 PCB 的迫切需求，抓住市场增长机遇。

PCB 产业正朝着高端化、差异化方向发展，高端服务器用 PCB 市场需求快速增长，已成为行业发展的主流趋势。公司依托技术储备优势快速切入算力硬件

升级主赛道，充分发挥资本市场融资效能，以本次募投项目为核心支点，批量投产适配 800G 及以上传输速率的高阶 HDI 板等高端产品，增强公司在数据通信等高增长领域的场景化产品覆盖能力，从而优化公司收入结构，提高市场竞争力。

(3) 优化产品结构，实现发展战略目标

PCB 产品种类繁多，目前行业内习惯以印制电路板的线路图层数、基材材质柔软性、技术、工艺等维度为标准将产品主要细分为单面板、双面板、多层板、刚性板、挠性板、刚挠结合板、HDI 板以及其他特殊板（高频板、铝基板、厚铜板等）。Prismark 最新预测表明，2025 年 PCB 细分市场中，封装基板、HDI 板及 18 层以上多层板三大领域将延续强劲增长态势。2025 年全球 PCB 细分产品产值 18 层以上多层板市场增长尤为突出，2025 年其产值预计同比攀升约 72.8%，中国 18 层以上多层板的增长曲线更为陡峭，产值同比增速预计高达约 119.2%。AI 服务器及 AI 数据中心对 PCB 技术要求远高于传统产品。一般情况下，AI 服务器 PCB 通常包含 20 至 28 层的多层结构，远超传统服务器的 12 至 16 层。在 AI 算力需求爆发、全球产业链重组的背景下，高端 PCB（如 18 层以上多层板、HDI、IC 载板）增速领先行业。

本项目聚焦的高阶 HDI 等数连产品，主要应用于光模块、GPU 加速卡、存储模块、半导体测试等领域，其生产制造涉及高密度互连技术、高频高速信号传输技术等多项核心工艺，技术壁垒高，行业准入门槛高，相较于传统 PCB 产品，具有更高的技术附加值和产品单价。

本次募集资金到位后，公司将进一步提升高端 HDI 板的出货占比，优化产品结构，满足数据通信等应用领域对数连产品用 PCB 的旺盛迭代需求，进而提升高附加值产品供给，实现公司发展战略目标。

3、项目实施的可行性

(1) 国家产业政策为本项目的实施提供政策基础

近年来，我国聚焦电子信息产业高端化、自主化发展，为此有关部门密集出台一系列产业政策。

2025年12月，工业和信息化部等八部门发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，指出“支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键技术”；2025年8月，国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，指出“支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地”；同年，工业和信息化部、市场监督管理总局发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，指出“推进人工智能服务器、高效存储等先进计算系统建设”、“加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度”。此外，《印制电路板行业规范条件》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《数字中国建设整体布局规划》《制造业可靠性提升实施意见》《算力基础设施高质量发展行动计划》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等产业政策多维度、多层次为本行业及下游应用领域构建起系统完备、协同联动、导向明确的政策支撑体系。

（2）高端 PCB 市场广阔，未来可期

根据 PrismaMark 数据显示，2025 年，全球电子系统市场规模上调至 2.81 万亿美元，同比增长 10%，其中服务器/数据存储市场超预期增长 42% 至 4,130 亿美元；2026 年预计突破 3 万亿美元，同比增长 8%，服务器市场仍为第一增长极（同比增 32%），核心驱动力是 AI 数据中心资本开支（CAPEX）激增。五大科技巨头（亚马逊、微软、谷歌、Meta 及甲骨文）的资本开支正以历史级速度扩张，高盛预计 2025 年为 3,800 亿美元，较 2024 年增加 1,500 亿美元，增速为 60%。除了服务器/数据中心和通信用 PCB 在 AI 的驱动下实现高速增长外，其他领域 PCB 均保持温和增长。

在市场需求旺盛，产业转化路径已具备经济规模的情况下，预计公司实施本项目可提升高端 PCB 的市场占有率，进一步增强公司的竞争实力。

（3）丰富的技术积累为本项目的实施提供技术保障

经过多年的研发与创新，公司已开发出一系列拥有自主知识产权专利技术，其中与本次募投项目相关较具代表性的有：①高端 PCB 技术实现关键突破。公司成功攻克 24 层、26 层超高层高精密 PCB 及 AI 服务器主板核心技术，厚铜、

阻抗、背钻、可靠性等关键指标达标，顺利通过客户认证，正式进入超算与 AI 服务器核心供应链，获取批量订单准入资格，支撑公司高端市场战略落地。②高速数通与 800G 光模块 PCB 实现规模化交付。公司已完成 800G 光模块 PCB 批量供货，构建高频高速、高精度对位、高可靠表面处理等关键工艺壁垒；攻克金手指硬金、化学镍钯金、窄边打线等技术难题，产品覆盖 100G~800G+全系列光模块与高速连接器需求。

子公司江苏博敏是公司重点培育的面向高端 PCB 市场的智能化生产平台，被认定为“国家级专精特新小巨人企业”，以高阶 HDI、光模块板等为核心产品，2025 年在 5G 高频高密度集成印制电路细分领域，先后攻克了精细线路制造、微孔制作、高频低损耗线路处理及无源器件集成等关键技术。目前，其 5G 高频高密度集成印制电路产品在细分市场中具备较强的竞争优势，未来发展前景广阔。

（4）优质的客户资源保证本项目产能消化

经过多年的经营积累，公司主营业务已积累了新能源/汽车电子、数据/通讯、智能终端、工控安防等高科技领域的优秀企业客户群体，终端客户包括华为、科大讯飞、禾赛科技、森萨塔、中兴通讯、三星电子、Jabil、歌尔股份、比亚迪、海光芯创、光迅科技、伟创力、华工科技、华阳通用、广汽、佛吉亚、富士康、联想、海信、亚马逊、现代、MOBIS、日海物联、华勤电子、欧司朗、美律电子和天马微电子等行业优质客户。近年来多次获得上述客户颁发的“最佳合作伙伴”“最佳供应商”“金牌供应商”等荣誉。

基于以上情况，未来本项目新增的高端产能，预计将能够依托现有已通过验证的客户渠道和持续扩大的配套需求，实现快速市场导入与规模化销售，从而有效保证本次募投项目的顺利达产与产能消化。

4、项目投资概算

本项目计划总投资 29,928.11 万元，拟通过本次发行募集 24,000.00 万元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	投资金额占投资总额比例	拟使用募集资金金额

1	设备购置及安装工程费	27,891.37	93.19%	24,000.00
2	预备费	836.74	2.80%	-
3	铺底流动资金	1,200.00	4.01%	-
投资总额		29,928.11	100.00%	24,000.00

5、项目实施进度

本项目计划分多个阶段实施完成，包括：设备购置、设备安装调试、员工招聘及培训、试生产、正式运行。具体进度安排如下：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	设备购置								
2	设备安装调试								
3	员工招聘及培训								
4	试生产								
5	正式运行								

6、项目经济效益

经测算，本项目达产期年均新增营业收入 88,539.79 万元，年均新增净利润 11,193.18 万元。本项目税后内部收益率为 14.68%，税后静态投资回收期为 6.23 年（含建设期），项目经济效益较好。

上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等同对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。

7、项目土地情况及备案审批情况

本项目属于江苏博敏已批准建设的“高密度互连印制电路板产业化建设项目”（批复文号：盐环表复〔2021〕82132号）的第二阶段建设，不新增用地、不新增厂房建筑物，产品种类未发生变化，属于原环评批复产能的继续建设，且建成后产能总量未超出原批复的规模，因此无需重新办理环境影响评价。

截至本报告公告日，本项目的备案手续正在办理中。

（二）补充流动资金及偿还银行贷款

1、项目基本情况

公司拟将本次募集资金中的 6,000.00 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司流动资金及优化财务结构需求，从而提高公司的资本实力。本项目不涉及备案或环评程序报批事项。

2、项目的必要性

公司所处的 PCB 行业属于资金密集型产业，产能扩建、技术研发和生产运营均需要持续的资金投入。近年来，为顺应 AI 算力产业发展趋势，公司持续加大在高端 PCB 领域的资本开支和研发投入，负债规模持续攀升、偿债压力逐年加剧。2023-2025 年末，公司资产负债率分别为 42.74%、52.84%和 57.35%，负债水平持续走高；其中短期借款余额分别为 76,435.60 万元、124,006.36 万元和 130,070.58 万元，长期借款余额分别为 88,554.61 万元、127,437.96 万元和 163,653.73 万元，长短期债务规模同步扩张，偿债压力持续增大。本次发行通过补充流动资金，可有效提升公司资本实力，缓解资金压力，为公司持续深耕高端 PCB 市场、落地产能升级、开展技术创新提供稳定的资金保障。

3、项目的可行性

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合现行法律法规及中国证监会、上海证券交易所等关于募集资金运用的相关规定。募集资金到位后，可匹配公司中长期业务发展资金需求，优化公司资本结构，降低资产负债率，提高偿债能力，改善财务状况，增强抗风险能力，符合公司及全体股东的核心利益。

三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目完成后，将进一步扩充高阶 HDI 等数连产品产能，有助于公司深度把握下游行业快速发展带来的市场机遇，持续巩固与头部厂商的供应链合作关系，推动公司在高端 PCB 细分领域的市场地位和品牌影响力进一步提升。本次发行募集资

金投资项目对公司推进经营战略布局、优化产品结构、增强核心竞争力具有积极作用，为公司实现可持续高质量发展奠定坚实基础。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产将相应增加，资产负债率有所下降，资本结构得到有效优化，财务稳健性进一步增强。同时，公司资金实力将大幅提升，营运资金得到有效补充，偿债能力及抗风险能力显著提高，为公司后续发展提供有效保障。

由于公司本次募集资金投资项目建设、产能爬坡、客户认证及效益释放需要一定周期，因此公司每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内可能存在被摊薄的风险。但从中长期来看，随着本次募集资金投资项目逐步建成投产并实现效益，公司高阶 HDI 等高端 PCB 产品的营收规模将持续增长，整体盈利能力、经营业绩和资产收益水平将稳步提升。

四、可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合国家相关产业政策与公司整体战略发展规划，具备充分的必要性和可行性。

一方面，本次募投项目顺应行业发展趋势，有助于公司突破现有产能瓶颈，把握 800G 及以上数连产品需求爆发的窗口期，进一步巩固和提升公司在高端 PCB 领域的规模效应与市场竞争力；另一方面，通过本次募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，可有效优化公司资本结构，降低资产负债率，缓解偿债压力，增强财务稳健性与抗风险能力。

公司在高端 PCB 领域已具备一定的技术积累、生产管理经验和客户资源，为本次募投项目的顺利实施提供了有力保障。本次募投项目的落地，将全面提升公司的综合竞争实力和持续盈利能力，为公司中长期战略目标的实现奠定坚实基础，符合公司及全体股东的核心利益。

博敏电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 5 日